

<<电子封装材料与工艺>>

图书基本信息

书名：<<电子封装材料与工艺>>

13位ISBN编号：9787502579791

10位ISBN编号：7502579796

出版时间：2006-3

出版时间：化学工业出版社

作者：查尔斯A.哈珀

页数：635

译者：中国电子学会电子封装专业委员会

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子封装材料与工艺>>

内容概要

本书由工作在电子封装第一线的各方面专家编写，内容涉及电子封装及相关领域的材料与工艺，包括半导体、塑料、橡胶、复合材料、陶瓷和玻璃以及金属等各种材料，也包括电子封装和组装的软钎焊、电镀与沉积金属涂层、印制电路板制造、混合微电路与多芯片模块的材料和工艺、电子组件中的粘接剂、下填料和涂层以及热管理材料及系统等各种工艺技术，较充分反映了当前电子封装各方面的先进材料与工艺，不仅理论分析充分，而且有丰富的实践经验总结，是关于电子封装材料和工艺的较为全面而实用的工具书。

为便于读者查阅，书后附有术语索引，并配有英文对照，以便于对专业术语的规范和理解。

本书对从事电子封装及相关行业的科研、生产、应用工作者都会有较高的使用价值，对高等院校相关专业的师生也具有一定的参考价值。

<<电子封装材料与工艺>>

书籍目录

第1章 集成电路芯片的发展与制造 1.1 简介 1.2 原子结构 1.3 真空管 1.4 半导体理论 1.4.1 二极管 1.4.2 结型双极晶体管 1.4.3 场效应晶体管 1.4.4 结型场效应晶体管 1.4.5 金属氧化物半导体场效应晶体管 1.4.6 互补型金属氧化物半导体场效应晶体管 1.5 集成电路基础 1.6 集成电路芯片制造 1.6.1 晶锭的生长与晶圆片的制备 1.6.2 洁净度 1.6.3 集成电路制造 参考文献

第2章 塑料、橡胶和复合材料 2.1 简介 2.2 基础 2.2.1 聚合物定义 2.2.2 聚合物的类型 2.2.3 结构和性能 2.2.4 合成 2.2.5 术语 2.3 热塑性塑料 2.3.1 丙烯酸树脂 2.3.2 氟塑料 2.3.3 酮树脂 2.3.4 液晶聚合物 2.3.5 尼龙 2.3.6 聚酰胺?酰亚胺 2.3.7 聚酰亚胺 2.3.8 聚醚酰亚胺 2.3.9 聚芳酯和聚酯 2.3.10 聚碳酸酯 2.3.11 聚烯烃 2.3.12 聚苯醚 2.3.13 聚苯硫醚 2.3.14 苯乙烯类聚合物 2.3.15 聚砜 2.3.16 乙烯基树脂 2.3.17 热塑性聚合物合金和共混物 2.4 热固性塑料 2.4.1 烯丙基树脂 2.4.2 双马来酰亚胺 2.4.3 环氧树脂 2.4.4 酚醛树脂 2.4.5 聚酯 2.4.6 聚氨酯 2.4.7 硅橡胶 2.4.8 交联热塑性塑料 2.4.9 氰酸酯树脂 2.4.10 苯并环丁烯 2.5 橡胶 2.5.1 橡胶的性能 2.5.2 橡胶的类型 2.5.3 热塑性橡胶 2.6 应用 2.6.1 层压板 2.6.2 模塑和挤压 2.6.3 注塑和灌注 2.6.4 粘接剂 2.6.5 有机涂层 参考文献

第3章 陶瓷和玻璃 3.1 简介 3.2 用于微电子的陶瓷互连 3.2.1 薄膜 3.2.2 厚膜第4章 金属 第5章 电子封装与组装的软钎焊技术 第6章 电镀和沉积金属涂层 第7章 印制电路板的制造 第8章 混合微电路与多芯片模块的材料与工艺 第9章 电子组件中的粘接剂 第10章 热管理材料及系统索引

<<电子封装材料与工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>